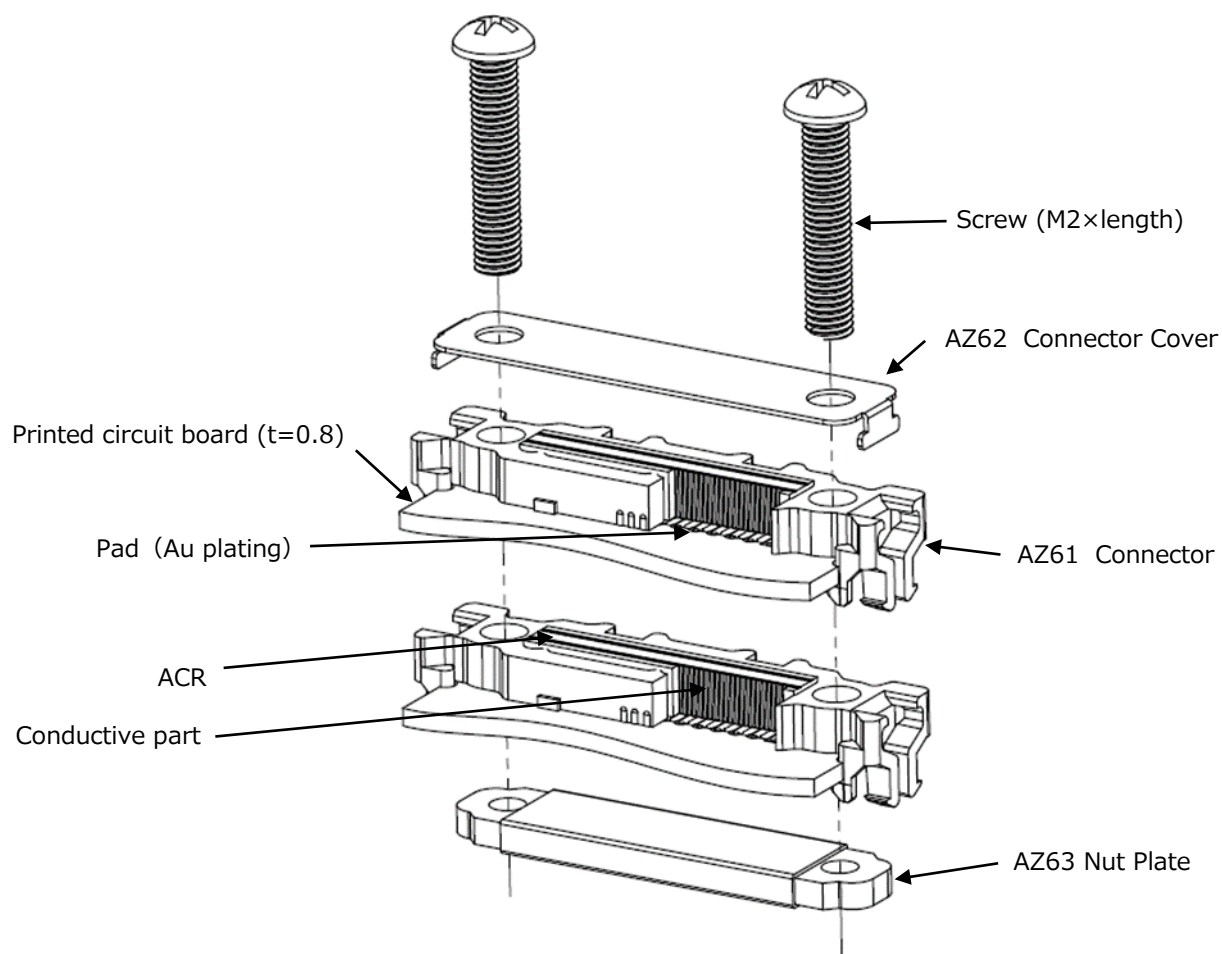


AZ61 Connector

1. 概要

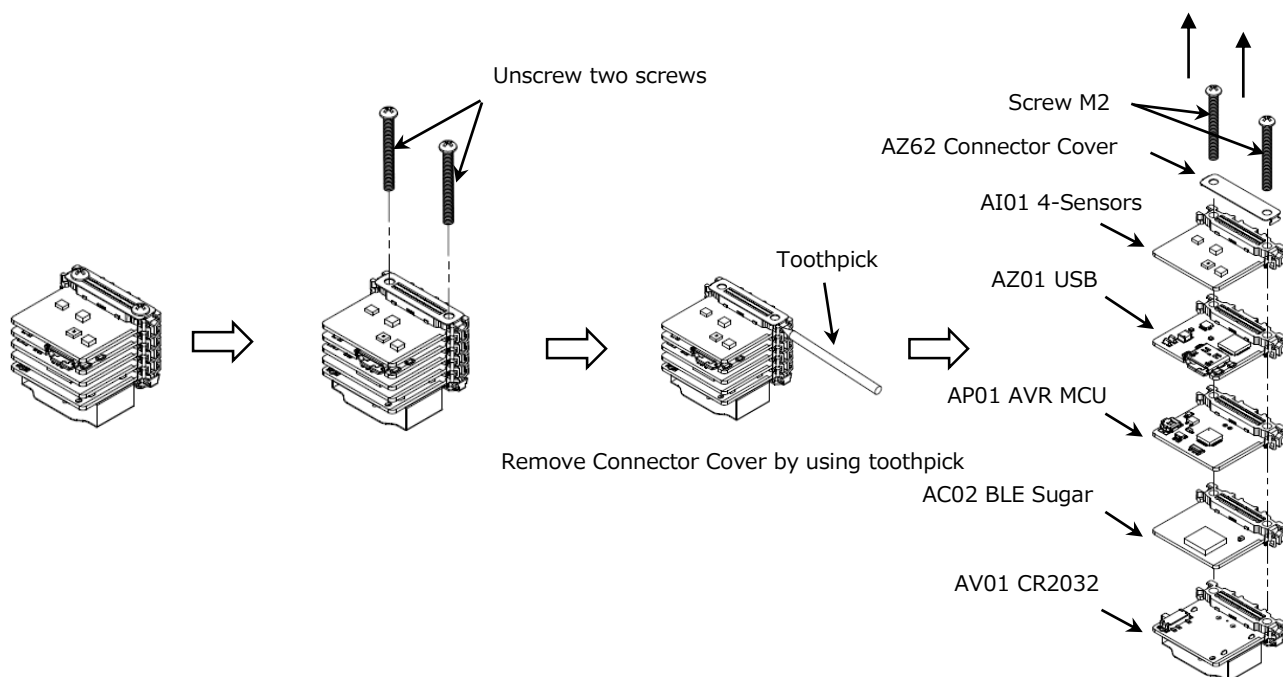
Leafony Platform は、ACR (Anisotropic Conductive Rubber)を採用しています。ACR は、絶縁性シリコンゴムに、金属又は導電性エラストマの導電部材が、狭ピッチで配列されており、圧縮されることで電氣的接続が実現できます。

リーフは、基板（PCB）、ACR、ACR を基板に固定する Connector holder、そして ACR を保護する Connector Cover で構成されています。Connector holder の両端の穴にねじを通して、基板間を締結させると、ACR が圧縮されて、電氣的接続が実現される仕組みになっています。

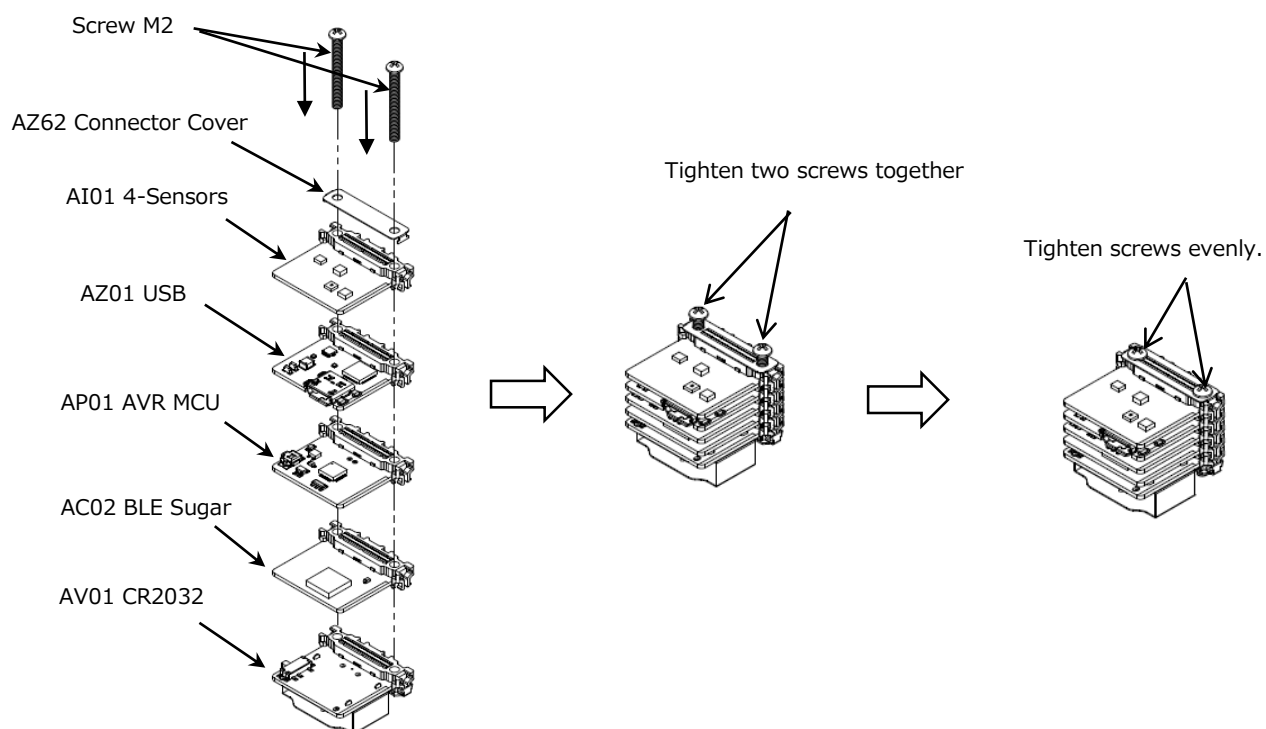


2. リーフの分解・組み立て方法

2-1. リーフの分解方法



2-2. リーフの組み立て方法

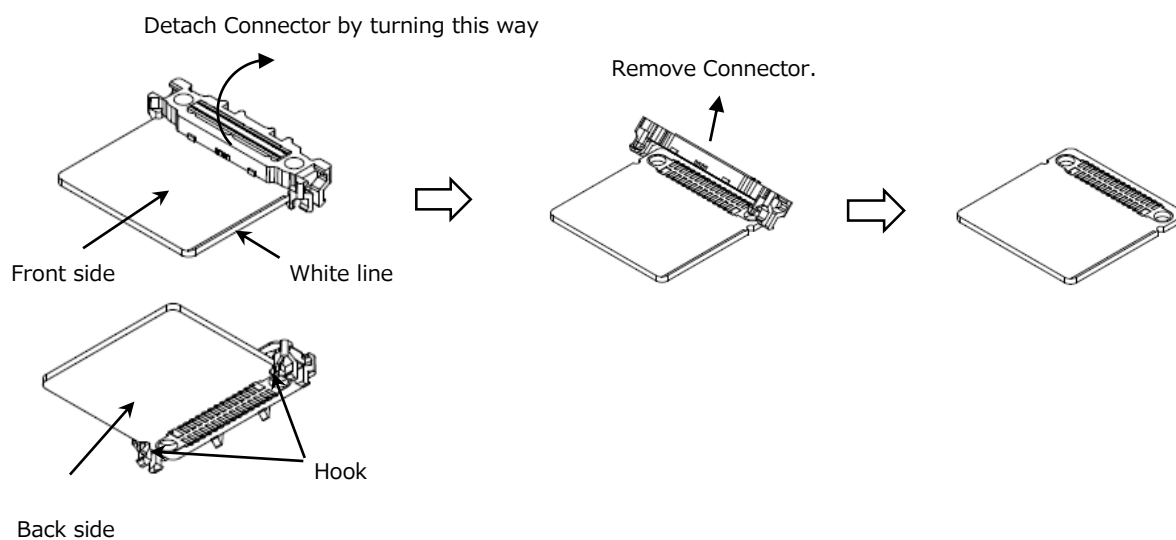


注：Connector や基板の接点に汚れが付着すると、接続不良が生じることがあります。その場合、無水エタノールを含ませた紙製ウエスで軽く拭いてください。それでも改善しない場合は、Connector を交換してください。

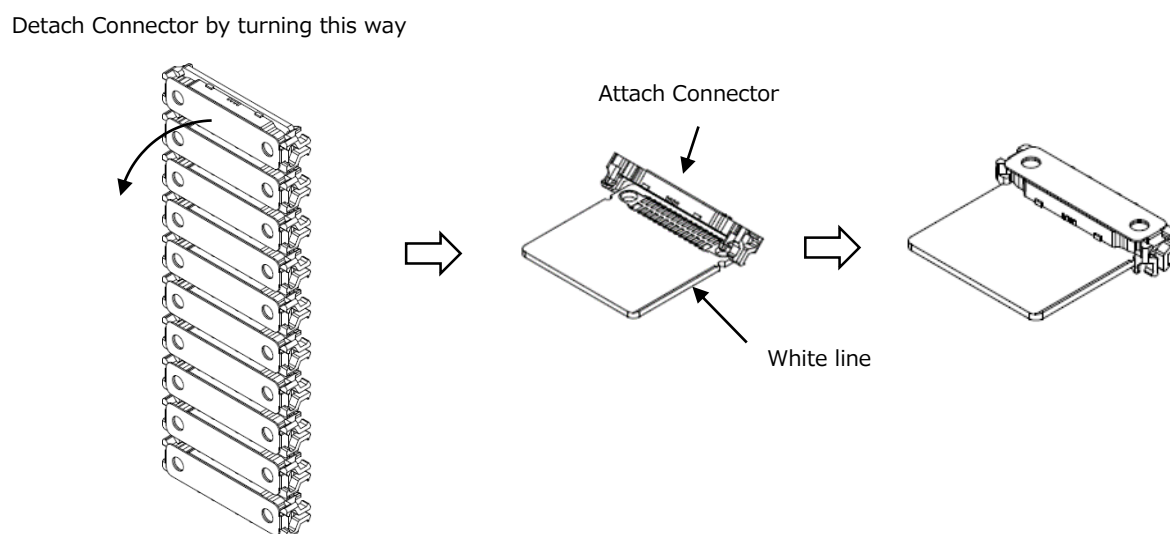


3. AZ61 Connector の分解・取り付け方法

3-1. AZ61 Connector の分解方法



3-2. AZ61 Connector の取り付け方法



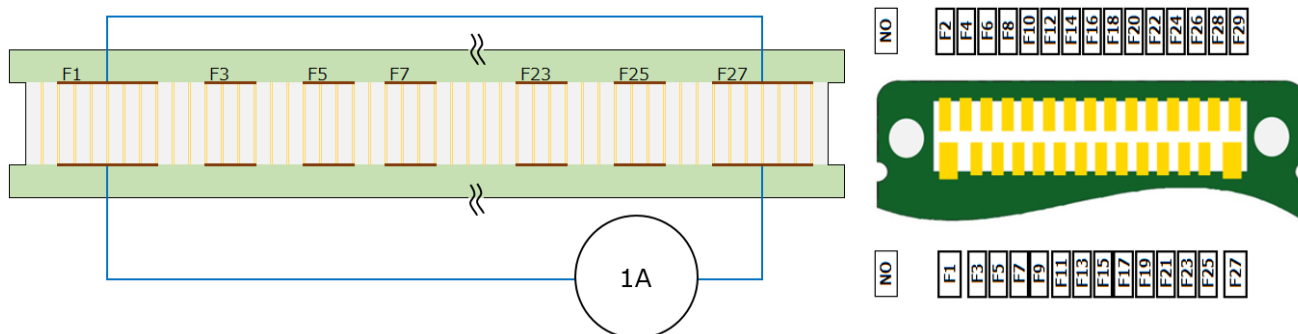
4. 電気的特性

本試験結果は、性能を保証するものではありません。最終製品にご使用になる場合は、各自で安全性や信頼性等の判断をされるようお願いいたします。

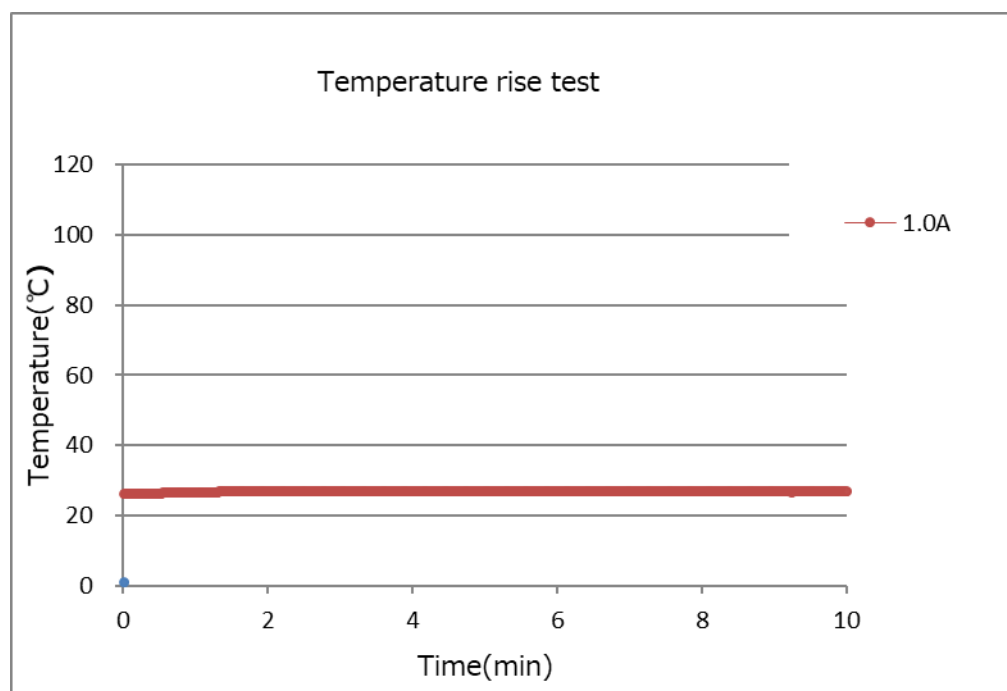
4-1. 温度上昇

試験方法

1A 印加時の F1 と F2 のピン周辺の温度を測定



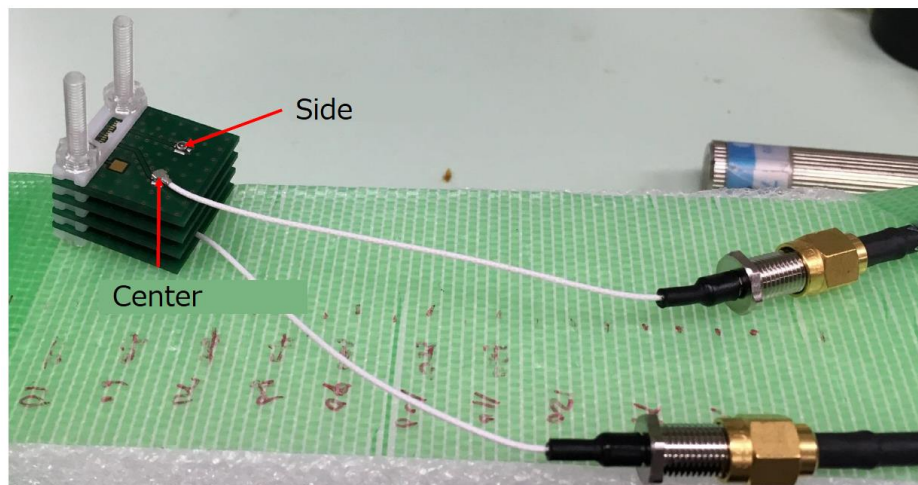
試験結果



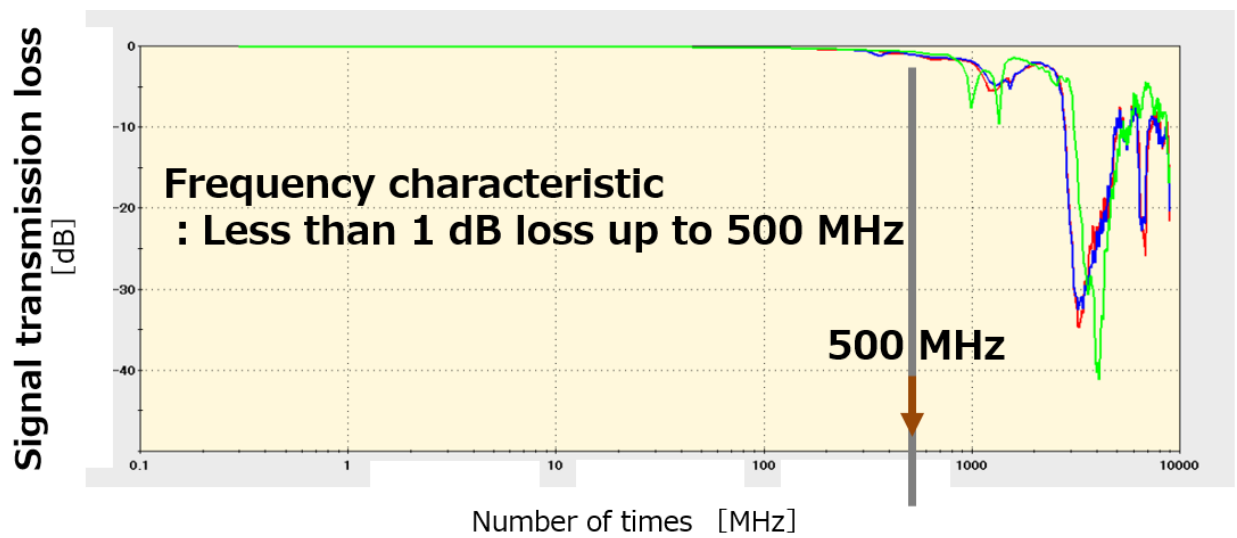
4-2. 高周波特性試験

試験方法

基板 4 枚をゴムコネクタで接続した時の S21 特性を測定



試験結果

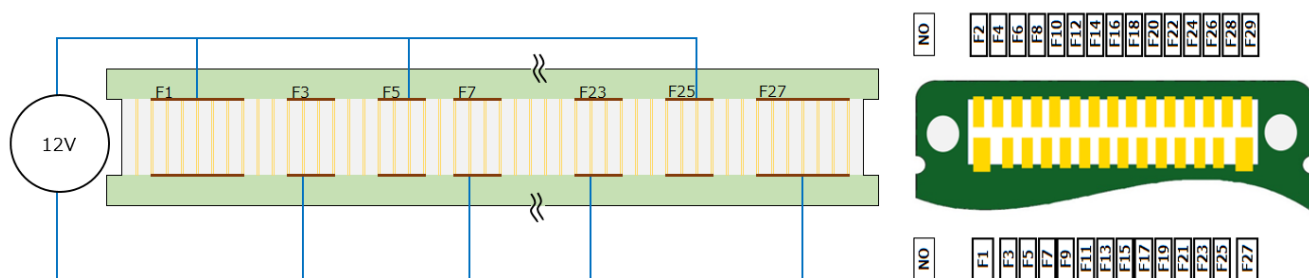


- : Center-Center Sample1
- : Center-Center Sample2
- : Side-Side Sample1

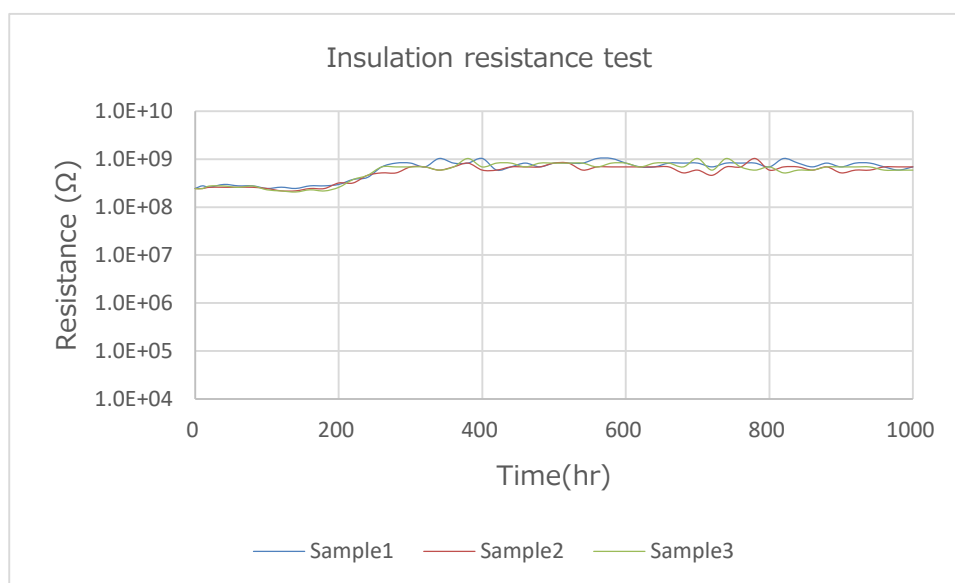
4-3. 絶縁抵抗試験

試験方法

85℃/85%、12V 印加時の絶縁抵抗を測定



試験結果



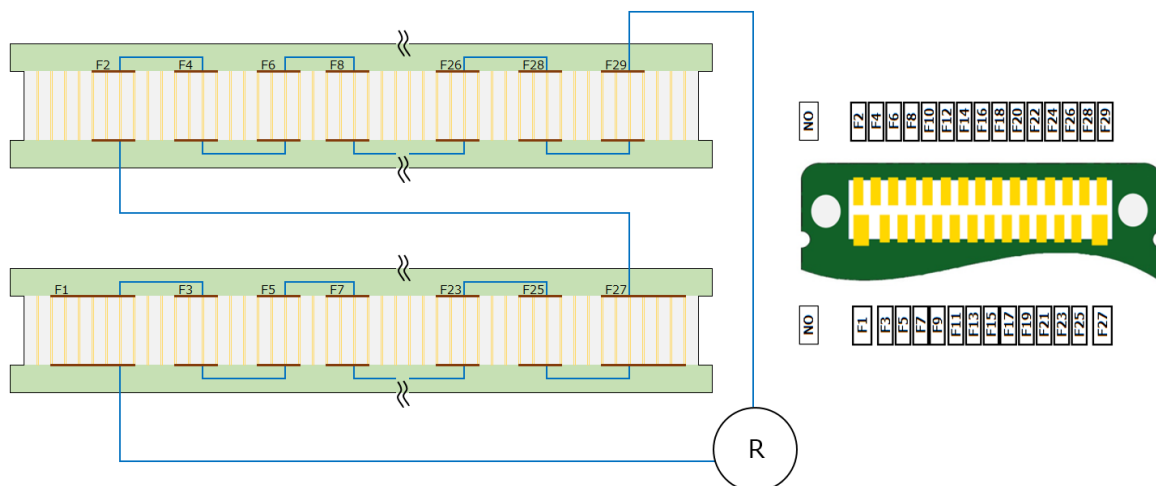
5. 信頼性試験

本試験結果は、性能を保証するものではありません。最終製品にご使用になる場合は、各自で安全性や信頼性等の判断をされるようお願いいたします。

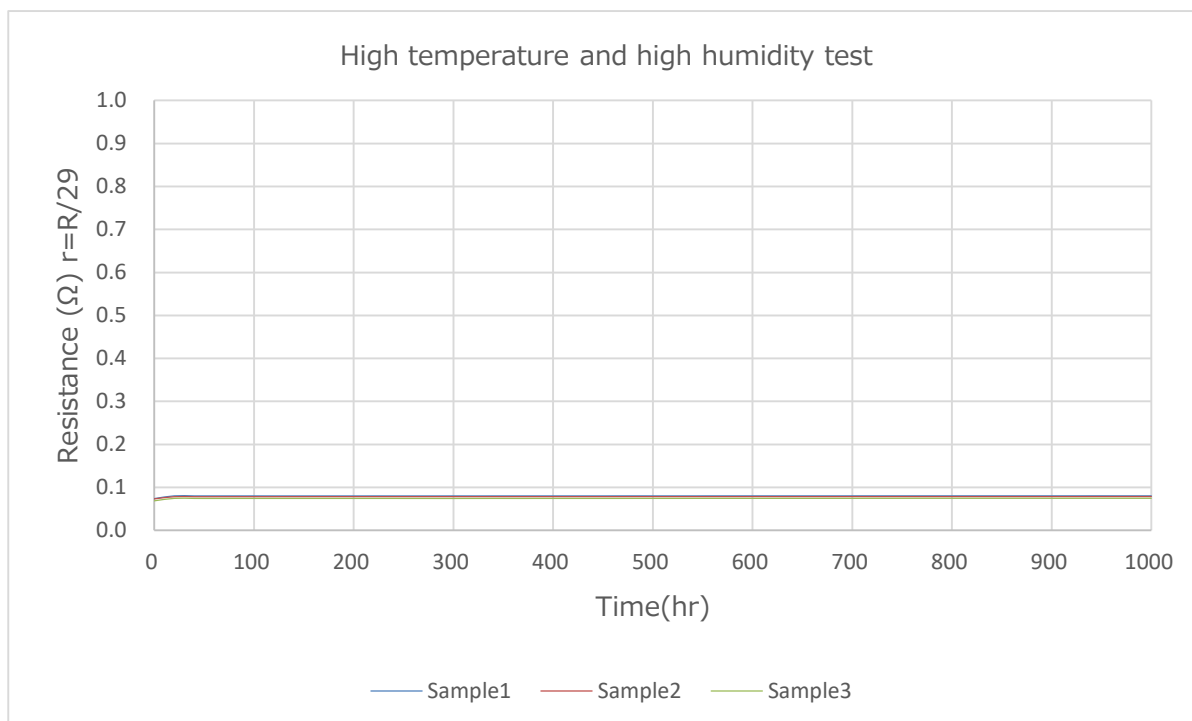
5-1. 高温高湿試験

試験方法

85℃/85%、1000 時間の抵抗値を測定



試験結果

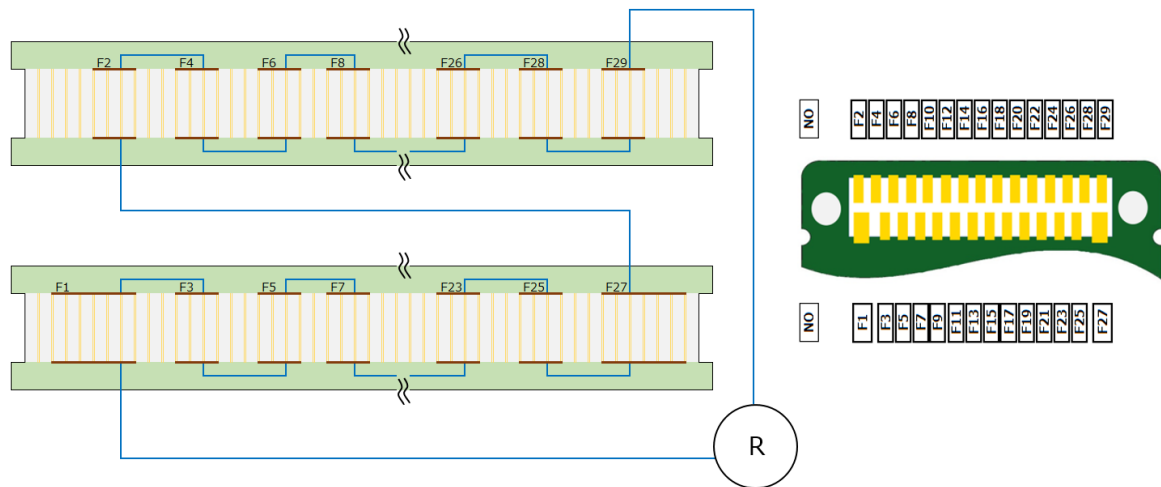


注) F1(3V3)と F27(GND)は他の Pad の 2 倍の幅があるため、抵抗値は約半分となります。

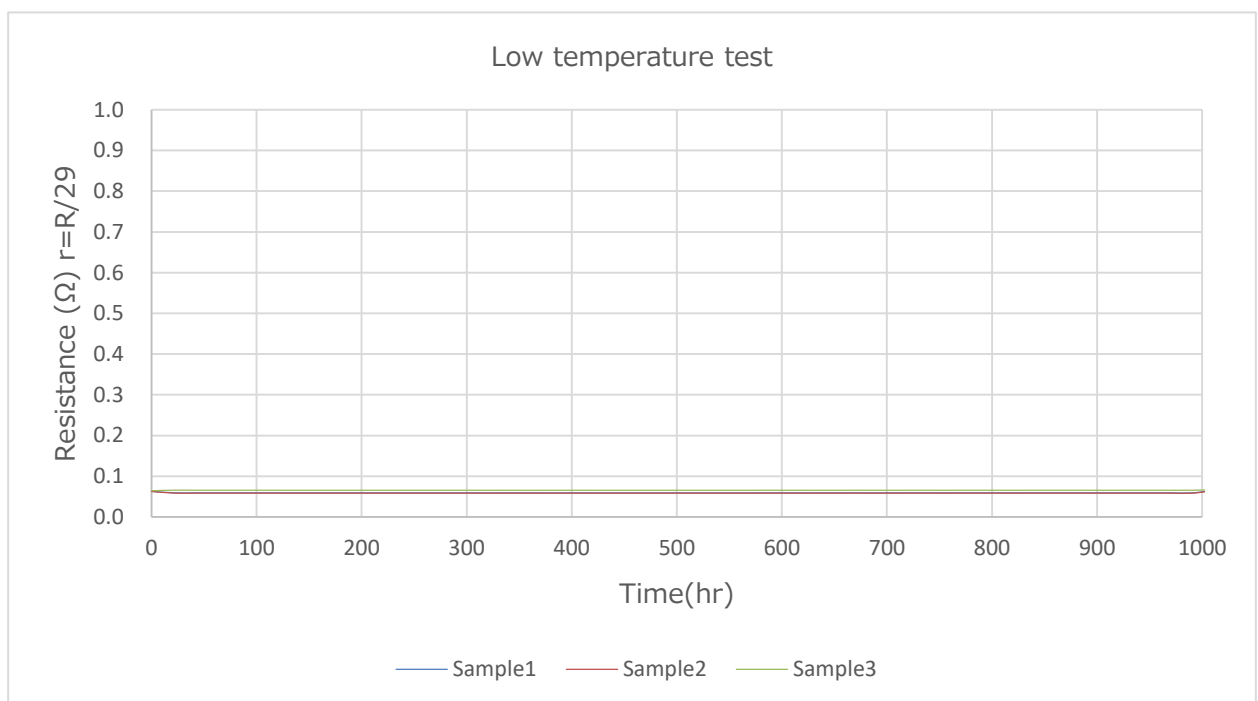
5-2. 低温試験

試験方法

-40℃、1000 時間の抵抗値を測定



試験結果

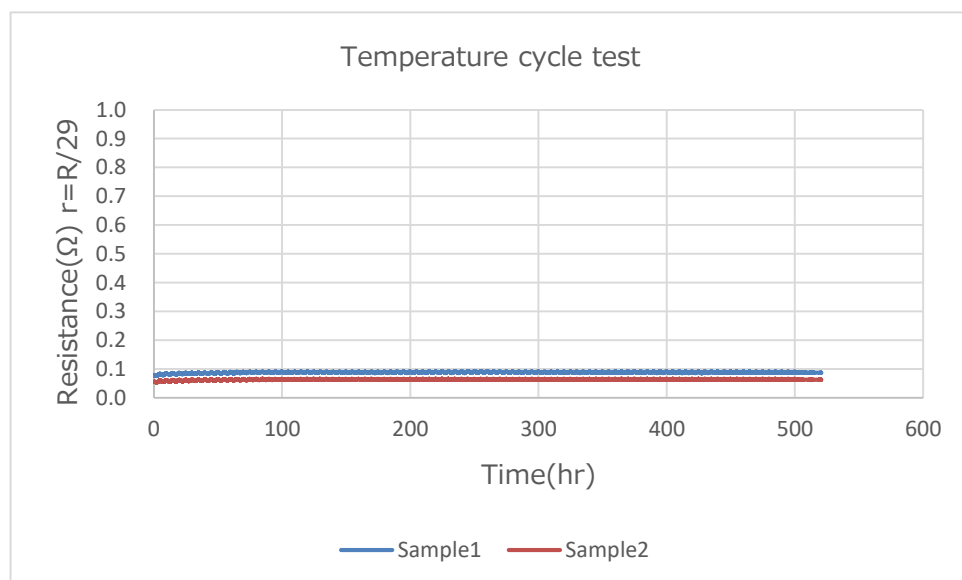
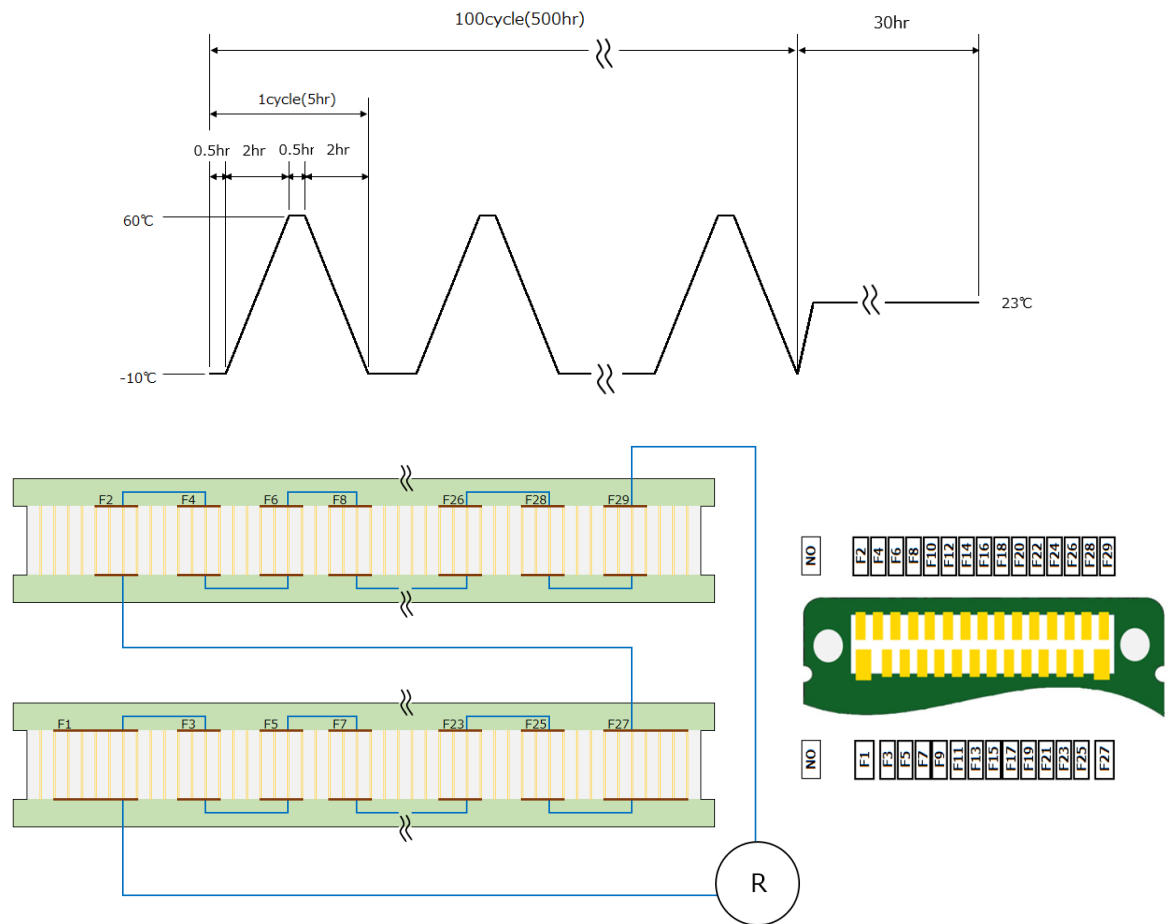


注) F1(3V3)と F27(GND)は他の Pad の 2 倍の幅があるため、抵抗値は約半分となります。

5-3. 温度サイクル試験

試験方法

-10⇔60℃の温度条件(以下参照)で抵抗値を測定

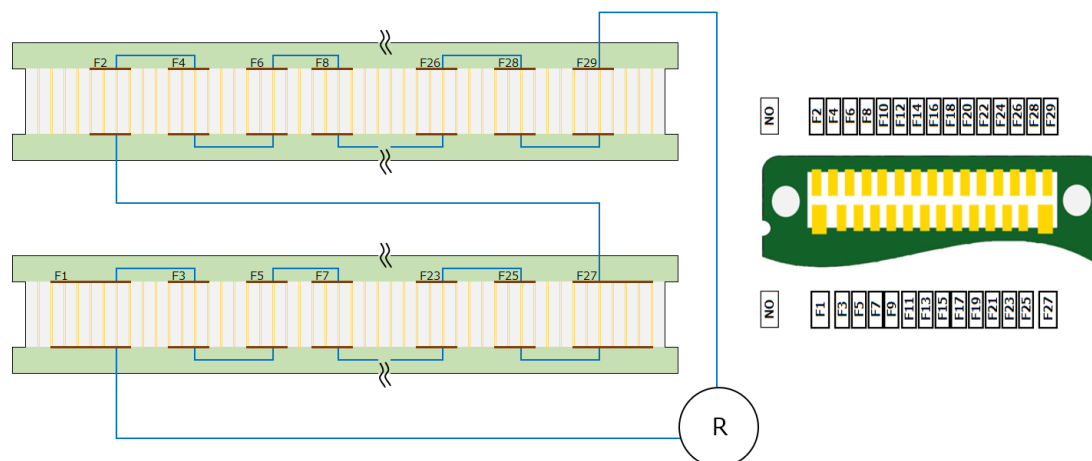


注) F1(3V3)とF27(GND)は他の Pad の 2 倍の幅があるため、抵抗値は約半分となります。

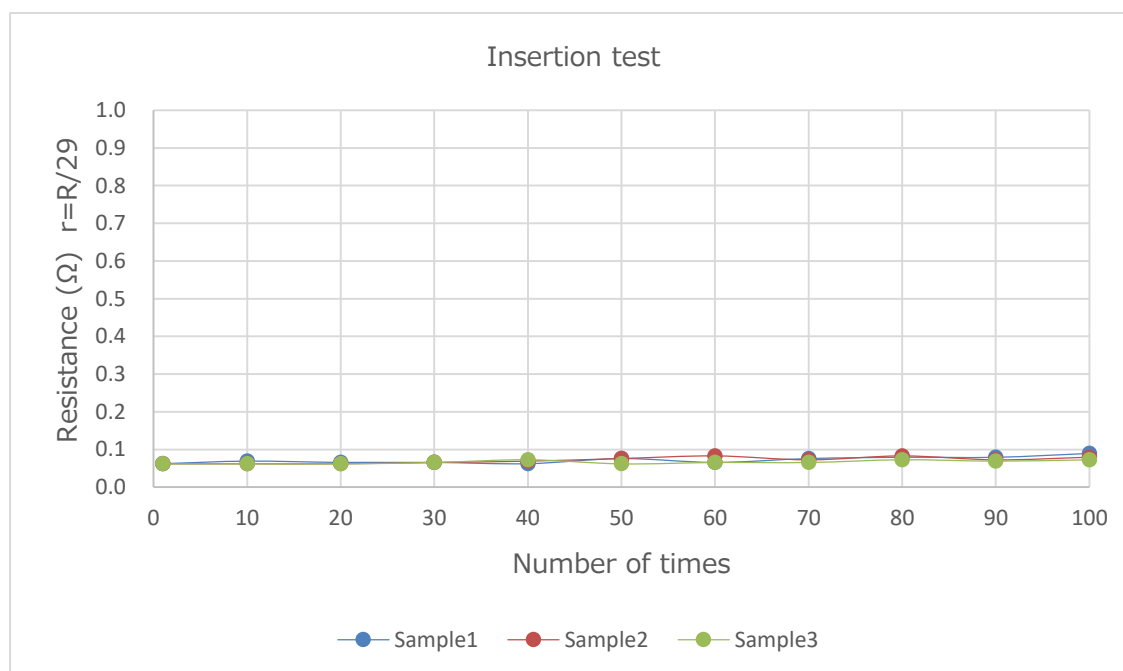
5-4. 挿抜試験

試験方法

1、10、20、…100 回までの抵抗値を測定



試験結果



注) F1(3V3)と F27(GND)は他の Pad の 2 倍の幅があるため、抵抗値は約半分となります。

6. 変更履歴

Rev A1.0: 2019 年 8 月初版